联络人
投资人关系
+886 3397 5999 ext. 1204
ir@winfoundry.com

稳懋半导体公告 2019 年第四季自结财务报告

2020 年 02 月 12 日

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(12)日公告 2019 年第四季自结财务报告。

2019 年第四季财务概况

- 本季合并营收新台币 69.04 亿元，为历史新高，较前季增加 8%，较去年同期增加 64%
- 本季合并毛利率为 44.2%，较前季增加 2.1 个百分点；本季营业净利率 33.7%，较前季增加 2.3 个百分点；均为历史新高
- 本季营业净利为新台币 23.29 亿元，为历史新高，较前季增加 16%，较去年同期增加 195%
- 本季税后净利为新台币 18.40 亿元，为历史新高，较前季增加 12%，较去年同期增加 151%；每股盈余为新台币 4.40 元，为历史新高，前季为新台币 3.90 元

2020 年第一季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- 第一季营收预计较前一季下滑 low-teens 百分比。
- 预计第一季毛利率约为 low-forties 的水平。

免责声明

本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外，公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。

管理者评论

"2019年对于稳懋可以说是丰收的一年，尽管年初时产业仍处于低迷的状态，但随着智能型手机市场状况的改变及客户的强劲需求，全年营收呈现逐季成长的趋势。第四季营收达新台币69.04亿元，再次达到单季历史高点，在产能满载的状况之下，毛利率超越上一季达到44.2%的新高峰，在营业利润率及净利率也都同创近三年单季新高之下，造就了EPS新台币4.4元的单季纪录。2019年全年营收较前一年成长23%，达新台币213.78亿元，全年EPS为新台币10.59元，亦双双改写历史新高。

时序迈入2020年，各国政府或电信商无不紧锣密鼓的加速释出5G频谱及从事5G基础建设，预期手机制造商也将推出多款5G机种以因应需求。根据多家研究机构的估计，预测全球5G智能型手机的渗透率将从2019年的1%上升到2020年的15~20%及2021年的超过30%的水平，因此可以推测今年5G将开始正式迈入成长期。稳懋做为全球无线通信功率放大器领导厂商，不仅早在几年前就已提供客户相关5G Cellular PA解决方案，并业已于2019年下半年大量出货，2019全年5G Cellular PA 营收已占全体Cellular PA 超过一成的里程碑，基地台相关的基础建设全年营收也较前一年成长超过五成，让公司对2020年5G的需求成长更具信心。此外，在光电组件方面，2019年3D感测仍延续既有的市场领先地位，展望今年将新增更多的应用及客户，为公司创造更大的贡献。为了满足客户的需求，稳懋最新的5,000片月产能扩充计划正如火如荼的进行中，期望为今年旺季贡献产能。

展望2020年第一季，因工作天数较少及受到传统淡季效应影响之下，预计季营收将较上一季下滑 low-teens 百分比，预计毛利率约为 low-forties 的水平。"

关于稳懋半导体

稳懋半导体成立于 1999 年，位于林口华亚科技园区，是全球首座以六英吋晶圆生产砷化镓微波集成电路(GaAs MMIC)的专业晶圆代工服务公司。稳懋拥有完整的技术团队及最先进的砷化镓微波晶体管及集成电路制造技术及生产设备，客户群除了全球射频集成电路设计公司(RFIC Design Houses)外，并致力吸引与全球整合组件制造(IDM)大厂合作。在制程技术发展方面，稳懋以多元化及领先为原则，期能提供客户最完整的服务。在无线宽带通讯的微波高科技领域中，稳懋目前提供两大类砷化镓晶体管制程技术：异质接面双极性晶体管(HBT)和应变式异质接面高迁移率晶体管(pHEMT)，二者均为最尖端的制程技术。在光通讯及 3D 感测领域中，稳懋更以 MMIC 生产技术为基础，提供光电产品的开发与生产制造。